

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投：孙芳芳；华西证券：卜灿华；仁布投资：方开俊
时间	2025 年 9 月 16 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司概况 通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。 公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。 公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实

现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超二万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年上半年分别实现营收 214.29 亿元、222.69 亿元、238.82 亿元和 130.38 亿元。公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年上半年的归母净利润分别为 5.02 亿元、1.69 亿元、6.78 亿元和 4.12 亿元。

二、行业情况

2025 年上半年，全球半导体市场在人工智能、汽车电子等各大领域的需求驱动下呈现结构性增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）宣布，上半年，全球半导体市场规模达 3,460 亿美元，同比增长 18.9%。同时，其对 2025 全年世界半导体市场规模的预测上调至 7,280 亿美元，较 2024 年提升 15.4%；而 2026 年半导体市场规模则有望达到 8,000 亿美元，进一步同比增长 9.9%。

半导体市场的持续增长是多种因素共同作用的结果。技术的不断革新，让半导体元件的性能得以不断优化，能够满足新兴领域对芯片算力、功耗、尺寸等方面的严苛要求。从市场需求端来看，智能汽车、工业 4.0 以及消费电子领域的创新发展，为半导体创造了广阔的市场空间。在国家政策的大力扶持下，国内企业更加坚定地走自主研发之路，加大研发投入，提升产业自主可控能力。

IDC 预计，2025 年全球半导体市场将呈现以下八大趋势：1、AI 驱动的高速增长态势仍将延续；2、亚太地区 IC 设计市场行情升温，2025 年有望再增长 15%；3、台积电将继续在晶圆代工领域占据主导地位；4、先进制程需求强劲，晶圆代工厂加速扩产；5、成熟制程市场行情回温，产能利用率将超 75%；6、2025 年为 2 纳米晶圆制造技术的关键之年；7、封测产业生态重塑，中国大陆市场份额将持续扩大，中国台湾地区 AI 封测优势提升；8、先进封装方面，扇出型面板级封装（FOPLP）深入布局，CoWoS 产

能倍增。

三、2024 年及 2025 年半年度业绩情况

2024 年，公司实现营业收入 238.82 亿元，同比增长 7.24%；公司实现归属于母公司股东的净利润 6.78 亿元，同比增长 299.90%。2025 年上半年，公司实现营业收入 130.38 亿元，同比增长 17.67%；公司归属于上市公司股东的净利润 4.12 亿元，同比增长 27.72%。其他 2024 年度及 2025 年半年详细情况，可以关注公司对外披露的公告。

四、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：公司封装技术水平如何？

回复：公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省集成电路先进封装测试重点实验室、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，先后与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密的合作关系，并聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，并取得了丰硕的技术创新成果。公司在发展过程中不断加强自主创新，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2025 年 6 月 30 日，集团累计专利申请量突破 1,700 件，其中发明专利占比近 70%；同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。

问题 3：2025 年上半年公司在哪些领域业务表现突出？

回复：2025 年上半年，随着手机芯片、汽车芯片国产化进程加快，家电等国补政策持续利好，公司紧抓机遇，在手机、家电、车载等众多应用领域提升公司市场份额，在 WiFi、蓝牙、MiniLed 电视显示驱动等消费电子热点领域，成为多家重要客户的战略合作伙伴；同时夯实与手机终端 SOC 客户合作基础，份额不断提升；依托工控与车规领域的技术优势，加速全球化布局，提升整体市场份额。

2025 年上半年，通富超威苏州和通富超威槟城继续深度融合，优化资源，通过不断的对标及改善，在质量体系建设，人才梯队培养，产品产能提升等方面都取得了卓越的成绩。同时，两家工厂充分结合市场策略，聚焦 AI 及高算力产品、车载智驾芯片的增量需求，积极扩充产能，拓展新客户资源，成功导入多家新客户。

问题 4：公司对 2025 年下半年行业发展情况怎么看？

回复：展望 2025 年下半年，业界分析认为，需求持续增长的 AI 和新能源汽车等新兴领域依旧是关键驱动力。存储、通信、汽车、工业等主要领域的需求逐步复苏。在技术驱动的新一轮上行周期与应用市场逐步复苏的叠加影响下，整体封测市场发展向好。未来，随着 5G、AIoT、智能汽车等新兴应用的普及，对封装技术提出了更高要求。中国封测企业需要在高密度集成、低功耗设计、高散热性能等关键技术领域持续突破，同时加强与国际先进企业的合作交流，共同推动封装技术的创新发展。在政策支持、市场需求和技术进步的多重驱动下，中国 IC 封测行业有望实现从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的历史性跨越。

问题 5：公司 2025 年上半年技术研发有什么进展？

回复：2025 年上半年，公司在大尺寸 FCBGA 开发方面取得重要进展，其中大尺寸 FCBGA 已开发进入量产阶段，超大尺寸 FCBGA 已预研完成并进入正式工程考核阶段；同时，公司通过产品结构优化、材料选型及工艺优化，解决了超大尺寸下的产品翘曲问题、产品散热问题。此外，公司在光电合封（CPO）领域的技术研发取得突破性进展，相关产品已通过初步可靠性测试。

在 Power 产品方面，公司的 Power DFN-clip source down 双面散热产品已研发完成，能够满足产品大电流、低功耗、高散

	热及高可靠性的要求。在传统打线类封装产品技术开发方面，通过传统圆片正反面镀铜的方式，来实现封装产品高散热、低功耗等性能提升。上半年针对 Cu wafer 封装的需要，研发建立了相关的工艺平台，完成了相关工艺技术升级，解决了 Cu wafer 在切割、装片、打线等封装工艺方面的技术难题。目前已成功在 Power DFN 全系列上实现大批量生产。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 9 月 16 日